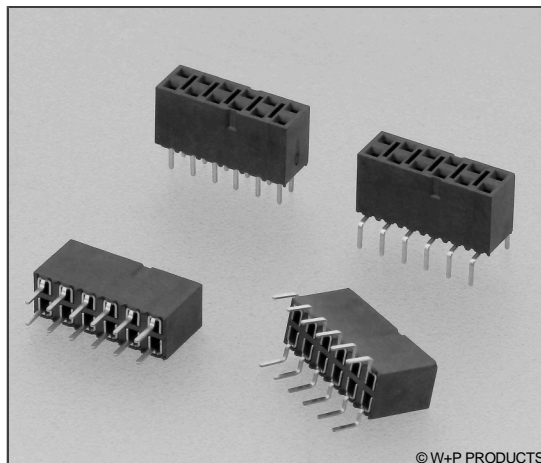


## Buchsenleisten RM 2,54mm, gerade, 2-reihig – BH 7,3mm, durchsteckbar Female Headers, 2.54mm Pitch, Straight, Double Row – 7.3mm Profile, Pass Through

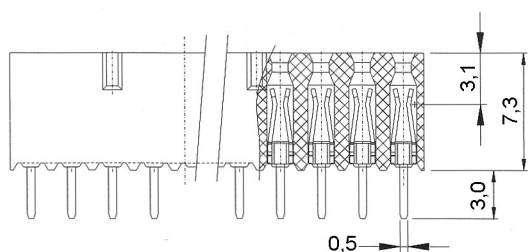
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kontakt für Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	Contact for square pin 0.635mm, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	500 V AC
Nennspannung	250 V AC
Voltage Rating	250 V AC
Nennstrom	3 A
Current Rating	3 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	Wave or reflow soldering

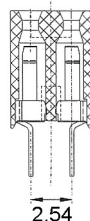


© W+P PRODUCTS

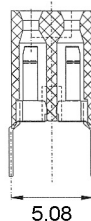
Doppelfederkontakte für Vierkantstifte 0,635mm.  
Dual beam contacts accept 0.635mm square pins.



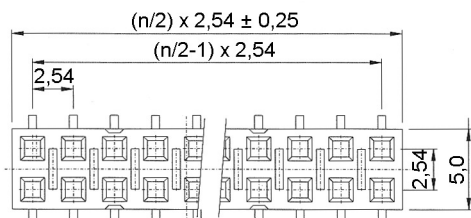
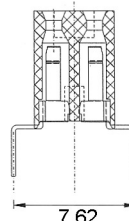
Layout 1



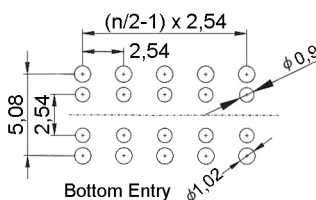
Layout 2



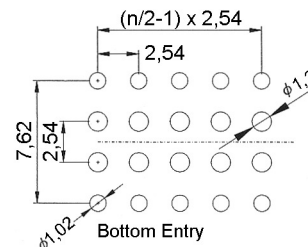
Layout 3



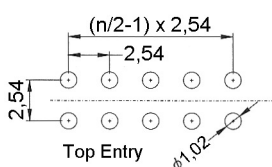
PCB-Layout



PCB-Layout



PCB-Layout



Series

**349**

Contacts\*

**04**

04-80 Zweireihig  
Double row

Layout\*

**1**

1 2,54 x 2,54mm  
2 2,54 x 5,08mm DIP spacing  
3 2,54 x 7,62mm DIP spacing

Plating\*

**50**

00 Vergoldet  
Gold plated  
50 Verzinkt  
Tin plated  
60 Sel. Au/Sn  
Duplex plating

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

# Informationen zum Wellen-Lötverfahren

## Wave Soldering Information

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

#### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

